

## Inhalt

		Seite
<i>K. G. Faas</i>	Begrüßung und Einführung	1
<i>G. Wolf</i>	Optischer Teilnehmeranschluß	5
<i>W. Engler</i>	Derzeitiger Stand der Einpreßtechnik	27
<i>D. Künzel</i>	Qualitätssicherung bei Steckverbindern aus der Sicht des Herstellers	41
<i>H.-G. Zielinski und G. Blume</i>	Anwenderorientierte Aspekte der Qualitätssicherung bei LWL-Steckverbindern	51
<i>Th. Ahrens und H. Hieber</i>	Mikrofehler in Verbindungen	69
<i>H.-D. Mieskes</i>	Kleben statt Löten — Möglichkeiten und Grenzen	79
<i>W. S. Ludolf</i>	Zweidrahtleitungen oder LWL?	157
<i>K. H. Möhrmann</i>	Kupfer oder Glasfaser zum Teilnehmer — Wettbewerb oder Ergänzung?	187
<i>R. Wetzels</i>	Einsatz von Glasfasern in LAN-Systemen	199
<i>W. Ehrfeld und A. Rogner</i>	Die LIGA-Technik in der integrierten Optik	217
<i>R. Roßberg</i>	LWL-Verschmelzkoppler	231
<i>A. Brockmeyer, W. Groh, T. F. Stehlin und J. Theis</i>	Polymere optische Fasern	251
<i>W. Eutin, J. A. Becker und W. Zell</i>	Verbindungstechnik optischer Ortsnetze	269
<i>K. Schulz und J.-R. Kropp</i>	Das FDDI-System, ein Industriestandard	285